



## 平成24年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成23年7月27日

上場取引所 東大

上場会社名 株式会社 日立ハイテクノロジーズ

コード番号 8036 URL <http://www.hitachi-hitec.com/>

代表者 (役職名) 執行役社長 (氏名) 久田 眞佐男

問合せ先責任者 (役職名) コーポレート・コミュニケーション部長 (氏名) 加藤 弘之

TEL 03-3504-5138

四半期報告書提出予定日 平成23年8月10日

配当支払開始予定日 —

四半期決算補足説明資料作成の有無 : 有

四半期決算説明会開催の有無 : 有 (アナリスト・機関投資家向け)

(百万円未満四捨五入)

### 1. 平成24年3月期第1四半期の連結業績(平成23年4月1日～平成23年6月30日)

#### (1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
24年3月期第1四半期	145,220	△8.4	3,210	△24.7	3,610	△28.2	2,035	△42.3
23年3月期第1四半期	158,477	19.6	4,264	—	5,028	—	3,529	—

(注) 包括利益 24年3月期第1四半期 1,825百万円 (△0.5%) 23年3月期第1四半期 1,835百万円 (—%)

	1株当たり四半期純利益	潜在株式調整後1株当たり四半期純利益
	円 銭	円 銭
24年3月期第1四半期	14.79	—
23年3月期第1四半期	25.66	—

#### (2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
24年3月期第1四半期	408,616	243,294	59.5
23年3月期	413,267	242,845	58.7

(参考) 自己資本 24年3月期第1四半期 243,145百万円 23年3月期 242,711百万円

### 2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
23年3月期	—	10.00	—	10.00	20.00
24年3月期	—	—	—	—	—
24年3月期(予想)	—	10.00	—	10.00	20.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

### 3. 平成24年3月期の連結業績予想(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

(%表示は、通期は対前期、第2四半期(累計)は対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
第2四半期(累計)	310,000	△7.5	8,000	△41.9	8,000	△44.2	5,000	△48.9	36.35
通期	680,000	4.1	28,000	0.4	28,000	△5.0	18,000	1.4	130.87

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 有

#### 4. その他

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 無  
新規 一社 (社名) 、 除外 一社 (社名)

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 有

(注)詳細は、添付資料5ページ「2. サマリー情報(その他)に関する事項 (2)四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
- ② ①以外の会計方針の変更 : 無
- ③ 会計上の見積りの変更 : 無
- ④ 修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数(普通株式)

① 期末発行済株式数(自己株式を含む)	24年3月期1Q	137,738,730 株	23年3月期	137,738,730 株
② 期末自己株式数	24年3月期1Q	199,278 株	23年3月期	199,127 株
③ 期中平均株式数(四半期累計)	24年3月期1Q	137,539,551 株	23年3月期1Q	137,541,626 株

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続が実施中であります。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記の業績予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成されたものであります。

実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。

業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料3ページ「1. 当四半期決算に関する定性的情報 (3)平成24年3月期 第2四半期連結累計期間及び通期の業績予想」をご覧ください。

添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報 .....	P. 2
(1) 当第1四半期連結累計期間の概況 .....	P. 2
(2) セグメント別の概況 .....	P. 2
(3) 平成24年3月期 第2四半期連結累計期間及び通期の業績予想 .....	P. 3
(4) キャッシュ・フローの状況 .....	P. 4
2. サマリー情報(その他)に関する事項 .....	P. 5
(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 .....	P. 5
(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 .....	P. 5
(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 .....	P. 5
3. 継続企業の前提に関する重要事象等の概要 .....	P. 5
4. 四半期連結財務諸表 .....	P. 6
(1) 四半期連結貸借対照表 .....	P. 6
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 .....	P. 8
(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 .....	P. 10
(4) 継続企業の前提に関する注記 .....	P. 11
(5) セグメント情報等 .....	P. 11
(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 .....	P. 12

## 1. 当四半期決算に関する定性的情報

### (1) 当第1四半期連結累計期間の概況

当第1四半期連結累計期間の経営成績は、売上高 145,220 百万円(前年同四半期連結累計期間(以下、前年同期)比 8.4%減)、営業利益 3,210 百万円(前年同期比 24.7%減)、経常利益 3,610 百万円(前年同期比 28.2%減)、四半期純利益 2,035 百万円(前年同期比 42.3%減)となりました。

### (2) セグメント別の概況

#### 電子デバイスシステム

半導体製造装置は、海外大手半導体メーカーの微細化投資を背景に、エッチング装置が、米国市場向けを中心に大幅に増加しました。測長SEMは、海外大手半導体メーカーによる大型設備投資の継続により、アジア・欧米市場向けを中心に需要は旺盛なもの、震災により出荷が延期となった影響を受け、当期としては微増となりました。一方、チップマウンタ及びダイボンドは、アジア市場における設備投資の延期等により微減となりました。

以上の結果、当セグメントの売上高は 23,087 百万円(前年同期比 37.0%増)、経常利益は 2,203 百万円(前年同期比 285.0%増)となりました。

#### ファインテックシステム

FPD関連製造装置は、テレビ用液晶パネルの価格下落等による、液晶パネルメーカーの収益悪化を背景に、露光装置、実装装置ともに減少しました。ハードディスク関連製造装置は、ハードディスクドライブメーカーの統合による影響が不透明なことから、顧客が設備投資に慎重となり、低調に推移しました。

以上の結果、当セグメントの売上高は 3,649 百万円(前年同期比 45.5%減)、経常損失は 1,324 百万円(前年同期は 176 百万円の経常損失)となりました。

#### 科学・医用システム

分析計測機器・解析装置は、材料関連分野等において需要が拡大したことに加え、震災により前年度末の出荷が当期に遅延したこと等も影響し、増加しました。一方、医用分析装置は、新製品の立ち上げ等により、海外市場向けを中心に需要は引き続き旺盛なもの、円高や震災による生産遅延等の影響を受け、大幅に減少しました。DNAシーケンサは、中小型装置の新製品投入効果等により好調に推移しました。

以上の結果、当セグメントの売上高は 25,362 百万円(前年同期比 7.8%減)、経常利益は 2,230 百万円(前年同期比 26.8%減)となりました。

#### 産業・ITシステム

自動組立システムは、震災による自動車メーカーの減産の影響を受け、減少しました。また、ハードディスクドライブも、震災によるサプライチェーンへの影響等により、低調に推移しました。通信用機器は、米国市場向け携帯電話が新規モデル拡販等により好調に推移しました。

以上の結果、当セグメントの売上高は 30,052 百万円(前年同期比 1.4%増)、経常損失は 243 百万円(前年同期は 325 百万円の経常損失)となりました。

### 先端産業部材

工業材料は、顧客の生産調整の影響を受け、液晶テレビ用樹脂原料等が大幅に減少しました。シリコンウェーハは、震災による顧客の生産停止の影響により減少しました。液晶関連部材も、同じく震災による顧客の生産停止により、大幅に減少しました。

以上の結果、当セグメントの売上高は 65,550 百万円(前年同期比 18.3%減)、経常利益は 400 百万円(前年同期比 63.7%減)となりました。

### (3)平成24年3月期 第2四半期連結累計期間及び通期の業績予想

世界経済は、日本の東日本大震災の影響に加え、米国の雇用環境の改善遅れや、欧州の財政不安等の懸念材料はあるものの、穏やかな回復傾向が続くと予想されます。また新興国については、インフレ懸念はあるものの、中国をはじめアジア諸国を中心に総じて堅調に推移するものと見込まれます。

当社を取り巻く環境は、半導体製造装置市場においては、パソコン需要に減速感があるものの、スマートフォンやタブレット端末などのモバイル関連機器市場の拡大を受け、今年度も好調を維持する見込みです。FPD関連製造装置市場は、中国大陸における液晶パネル生産投資計画の遅延から、投資規模・時期が依然不透明な状況にあります。またハードディスク関連製造装置市場においては、業界再編等により、市場成長の一時的な鈍化が予想されます。科学・医用システム関連市場は、欧州および中国を中心としたアジア諸国向けの需要は堅調と予測されますが、価格競争の激化や円高の影響が懸念されます。産業・ITシステム、先端産業部材では、米国市場向け携帯電話や太陽電池関連部材等の外需は堅調が予想されるものの、車載用ハードディスクドライブや電子デバイス・材料等、大震災による国内市場への影響が継続することが懸念されます。

以上により、当社の第2四半期連結累計期間の業績予想は、売上高 310,000 百万円(前年同期比 7.5%減)、営業利益 8,000 百万円(前年同期比 41.9%減)、経常利益 8,000 百万円(前年同期比 44.2%減)、四半期純利益 5,000 百万円(前年同期比 48.9%減)としております。

また、通期の業績予想は、売上高 680,000 百万円(前期比 4.1%増)、営業利益 28,000 百万円(前期比 0.4%増)、経常利益 28,000 百万円(前期比 5.0%減)、当期純利益 18,000 百万円(前期比 1.4%増)としております。

今後とも、ハイテク・ソリューション事業におけるグローバルトップを目指すとともに、最先端・最前線の事業創造企業として、顧客及び市場のニーズにスピーディーに対応し、業績予想の達成を目指してまいります。

#### (4) キャッシュ・フローの状況

当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は99,225百万円となり、前連結会計年度末より8,479百万円減少しました。各キャッシュ・フローの状況とその主な要因は以下の通りです。

##### (営業活動によるキャッシュ・フロー)

当第1四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期連結累計期間(以下、前年同期)に比べて7,842百万円増加し、1,935百万円の収入となりました。前年同期に対するキャッシュ・フローの主な増加要因は、運転資金としての売上債権、たな卸資産、仕入債務の増減による支出が4,868百万円減少したこと、その他の資産・負債の増減額に含まれる営業取引にかかわる前受金による収入が4,083百万円増加したことによります。一方で、前年同期に対するキャッシュ・フローの主な減少要因は、税金等調整前四半期純利益が1,695百万円減少したことによります。

##### (投資活動によるキャッシュ・フロー)

当第1四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べて3,663百万円減少し、8,512百万円の支出となりました。前年同期に対するキャッシュ・フローの主な減少要因は、その他の資金運用による支出が7,000百万円増加したことによります。一方で、前年同期に対するキャッシュ・フローの主な増加要因は、前年同期に㈱ルネサス東日本セミコンダクタ山梨工場の半導体製造装置事業の譲受に伴い3,315百万円を支出したことによります。

以上により、営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローを合計したフリー・キャッシュ・フローは前年同期に比べて4,179百万円増加し、6,577百万円の支出となりました。

##### (財務活動によるキャッシュ・フロー)

当第1四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同期と同額の1,368百万円の支出となりました。

当社グループの財務政策として、業容拡大に伴う運転資金及び研究開発投資・設備投資に対応するための適切な流動性の維持と資金の確保、並びに健全なバランスシートの維持を図りながら、財務基盤の強化を行ってまいります。具体的には、連結ベースでの営業本部別キャッシュ・フローを管理することで、営業活動におけるキャッシュ創出に対する意識を高め、売掛金の早期回収やたな卸資産の圧縮等による運転資金の改善促進を行い、フリー・キャッシュ・フローの増加に努めてまいります。

また、当社グループでのキャッシュ・プーリングによりグループ内の資金の効率化を図るとともに、日立グループでのキャッシュ・プーリングも活用することで、流動性の維持と収益性の向上を図ってまいります。

更に、日立グループ共通の経営管理指標である「F I V」(経済付加価値)による業績評価を徹底することで、当社グループ全体での資産効率向上を促し、資本コストを上回る利益を安定的に確保できる経営体制を目指してまいります。

## 2. サマリー情報(その他)に関する事項

### (1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

該当事項はありません。

### (2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

#### ① 原価差異の繰延処理

操業度により発生した原価差異に関して、原価計算期間末までにほぼ解消が見込まれる場合は、当該原価差異を流動資産又は流動負債「その他」として繰り延べることとしております。

#### ② 税金費用の計算

当第1四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を使用する方法によっております。

### (3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

該当事項はありません。

## 3. 継続企業の前提に関する重要事象等の概要

該当事項はありません。

4. 四半期連結財務諸表  
(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成23年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成23年6月30日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	24,968	22,944
受取手形及び売掛金	130,093	117,026
有価証券	80	82
商品及び製品	27,442	29,234
仕掛品	38,366	44,616
原材料	3,030	3,710
関係会社預け金	80,609	81,815
その他	27,386	28,645
貸倒引当金	△1,552	△1,331
流動資産合計	330,422	326,741
固定資産		
有形固定資産	53,873	53,315
無形固定資産		
のれん	1,095	1,015
その他	5,155	5,132
無形固定資産合計	6,249	6,146
投資その他の資産		
その他	23,739	23,443
貸倒引当金	△1,016	△1,030
投資その他の資産合計	22,723	22,413
固定資産合計	82,846	81,875
資産合計	413,267	408,616

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成23年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成23年6月30日)
<b>負債の部</b>		
流動負債		
支払手形及び買掛金	94,920	89,787
未払法人税等	3,965	2,976
製品保証引当金	2,227	2,164
災害損失引当金	1,082	1,562
その他	40,679	41,349
流動負債合計	142,874	137,838
固定負債		
退職給付引当金	26,323	26,559
役員退職慰労引当金	306	231
その他	920	693
固定負債合計	27,549	27,484
負債合計	170,423	165,322
<b>純資産の部</b>		
株主資本		
資本金	7,938	7,938
資本剰余金	35,745	35,745
利益剰余金	200,920	201,580
自己株式	△325	△325
株主資本合計	244,279	244,938
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	3,314	3,287
繰延ヘッジ損益	15	194
為替換算調整勘定	△4,897	△5,273
その他の包括利益累計額合計	△1,568	△1,793
少数株主持分	134	149
純資産合計	242,845	243,294
負債純資産合計	413,267	408,616

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書  
【四半期連結損益計算書】  
【第1四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自平成22年4月1日 至平成22年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成23年4月1日 至平成23年6月30日)
売上高	158,477	145,220
売上原価	134,382	121,687
売上総利益	24,096	23,533
販売費及び一般管理費	19,832	20,323
営業利益	4,264	3,210
営業外収益		
受取利息	85	92
受取配当金	52	63
貸倒引当金戻入額	254	199
雑収入	429	172
営業外収益合計	820	526
営業外費用		
支払利息	20	17
固定資産処分損	21	41
雑損失	15	69
営業外費用合計	56	126
経常利益	5,028	3,610
特別損失		
災害による損失	—	580
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	303	—
特別損失合計	303	580
税金等調整前四半期純利益	4,725	3,031
法人税等	1,181	977
少数株主損益調整前四半期純利益	3,544	2,053
少数株主利益	15	19
四半期純利益	3,529	2,035

【四半期連結包括利益計算書】  
 【第1四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自平成22年4月1日 至平成22年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成23年4月1日 至平成23年6月30日)
少数株主損益調整前四半期純利益	3,544	2,053
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△564	△28
繰延ヘッジ損益	296	178
為替換算調整勘定	△1,441	△378
その他の包括利益合計	△1,709	△228
四半期包括利益	1,835	1,825
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	1,836	1,810
少数株主に係る四半期包括利益	△1	16

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自平成22年4月1日 至平成22年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成23年4月1日 至平成23年6月30日)
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>		
税金等調整前四半期純利益	4,725	3,031
減価償却費	2,046	1,987
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	303	—
のれん償却額	80	80
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	314	234
その他の引当金の増減額 (△は減少)	△211	166
受取利息及び受取配当金	△137	△156
支払利息	20	17
売上債権の増減額 (△は増加)	4,529	12,267
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△11,734	△9,461
仕入債務の増減額 (△は減少)	918	△4,224
その他の資産・負債の増減額	△4,748	108
その他	△158	156
小計	△4,054	4,203
利息及び配当金の受取額	116	140
利息の支払額	△4	△4
法人税等の支払額	△1,966	△2,404
営業活動によるキャッシュ・フロー	△5,907	1,935
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
有価証券の売却による収入	4	1
有形及び無形固定資産の取得による支出	△1,574	△1,550
有形及び無形固定資産の売却による収入	45	37
投資有価証券の取得による支出	△9	—
貸付金の回収による収入	0	—
事業譲受による支出	△3,315	—
その他	—	△7,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△4,849	△8,512
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>		
配当金の支払額	△1,365	△1,366
その他	△3	△2
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,368	△1,368
現金及び現金同等物に係る換算差額	△1,313	△534
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△13,437	△8,479
現金及び現金同等物の期首残高	90,188	107,704
現金及び現金同等物の四半期末残高	76,751	99,225

(4) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(5) セグメント情報等

【セグメント情報】

前第1四半期連結累計期間(自 平成22年4月1日 至 平成22年6月30日)

① 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：百万円)

	報告セグメント						その他 (注)	合計	調整額	四半期連結 損益計算書 計上額
	電子デバイス システム	ファイ ン テック システム	科学・医用 システム	産業・IT システム	先端産業 部材	計				
売上高										
外部顧客への売上高	16,824	6,683	27,237	27,794	79,764	158,303	175	158,477	—	158,477
セグメント間の内部 売上高又は振替高	26	15	268	1,832	469	2,610	60	2,669	△2,669	—
計	16,850	6,697	27,505	29,626	80,233	160,912	234	161,146	△2,669	158,477
セグメント利益 又は損失(△)	572	△176	3,046	△325	1,102	4,219	△2	4,216	812	5,028

(注)「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、間接補助事業等を含んでおります。

② 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位：百万円)

利益	金額
報告セグメント計	4,219
「その他」の区分の損失	△2
セグメント間取引消去	△19
配分していない全社ののれんの償却額	△22
社内借入金に対する利子の戻入額	184
その他の調整額(注)	670
四半期連結損益計算書の経常利益	5,028

(注)その他の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない販売費及び一般管理費、営業外収益及び営業外費用であります。

③ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

(のれんの金額の重要な変動)

「電子デバイスシステム」セグメントにおいて、平成22年4月1日付で、当社100%子会社である㈱日立ハイテクインスツルメンツが、㈱ルネサス東日本セミコンダクタの半導体製造装置事業の一部を吸収分割承継しました。

なお、当該事象によるのれんの計上額は、当第1四半期連結累計期間においては1,145百万円であります。

当第1四半期連結累計期間(自平成23年4月1日至平成23年6月30日)

①報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：百万円)

	報告セグメント						その他 (注)	合計	調整額	四半期連結 損益計算書 計上額
	電子デバイス システム	ファイン テック システム	科学・医用 システム	産業・IT システム	先端産業 部材	計				
売上高										
外部顧客への売上高	23,039	3,646	25,106	28,240	65,060	145,091	129	145,220	—	145,220
セグメント間の内部 売上高又は振替高	48	3	257	1,812	490	2,609	914	3,523	△3,523	—
計	23,087	3,649	25,362	30,052	65,550	147,701	1,043	148,743	△3,523	145,220
セグメント利益 又は損失(△)	2,203	△1,324	2,230	△243	400	3,266	△223	3,043	567	3,610

(注)「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、間接補助事業等を含んでおります。

②報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位：百万円)

利益	金額
報告セグメント計	3,266
「その他」の区分の損失	△223
セグメント間取引消去	△43
配分していない全社ののれんの償却額	△22
社内借入金に対する利子の戻入額	197
その他の調整額(注)	435
四半期連結損益計算書の経常利益	3,610

(注)その他の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない販売費及び一般管理費、営業外収益及び営業外費用であります。

(6)株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項はありません。